

证券代码：300460

证券简称：惠伦晶体

公告编号：2021-014

广东惠伦晶体科技股份有限公司

关于向全资子公司惠伦晶体（重庆）科技有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月8日召开第三届董事会第二十一次会议，本次会议以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于对全资子公司惠伦晶体（重庆）科技有限公司增资的议案》，具体情况如下：

为增强公司全资子公司惠伦晶体（重庆）科技有限公司（以下简称“重庆惠伦”）资金实力，便于重庆惠伦顺利开展经营活动，公司拟以自筹资金对重庆惠伦增资人民币11,000万元。此次增资完成后，重庆惠伦的注册资本由人民币9,000万元增加至人民币20,000万元。

一、增资标的基本情况

公司名称：惠伦晶体（重庆）科技有限公司

注册资本：9000万元人民币

法定代表人：韩巧云

公司住所：重庆市万盛经开区鱼田堡高新技术产业园

成立日期：2020年6月2日

经营范围：电子专用材料研发，物联网技术研发，智能控制系统集成，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，电子元器件制造，光电子器件制造，其他电子器件制造，电子元器件与机电组件设备销售，电力电子元器件销售，光电子器件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要财务数据：重庆惠伦于2020年6月2日成立，目前处于开办建设环节，尚未开展任何经营活动。

二、本次增资的影响和风险

1、公司对重庆惠伦以现金方式进行增资，可增强其资金实力，满足重庆惠

伦未来经营发展对资金的需求，促进重庆惠伦良性运营和可持续发展，符合公司发展战略规划和长远利益。

2、本次增资后，重庆惠伦仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务状况和未来的经营成果造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

3、本次增资后，重庆惠伦在未来生产经营过程中，因市场、行业、内部控制等因素仍可能引致不确定性风险。对此，公司将充分关注行业及市场的变化，采取一系列措施规避和控制可能面临的风险，以不断适应业务要求及市场变化来降低相关风险。

三、其他

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》及《广东惠伦晶体科技股份有限公司章程》的有关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需经公司股东大会审议。本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

四、备查文件

1、第三届董事会第二十一次会议决议

特此公告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会

2021年2月8日